

技術詞彙表

於本文件中，除非文義另有所指，本文件中使用的與本公司及我們的業務有關的若干詞彙的解釋及定義載於下文。該等詞彙及其涵義未必與標準行業定義或用法一致。

「AEC-Q100」	指	汽車應用中使用的基於失效機制的封裝集成電路應力測試標準
「ASIC」	指	專用芯片，一種為專門應用需求定制的電機驅動控制芯片
「車規級」	指	車規級芯片是指經過專門設計、製造及鑒定以滿足汽車行業嚴格要求及標準(如AEC-Q100)的芯片
「BDC電機」	指	直流有刷電機，一種內含電刷裝置將直流電能轉換為機械能的電機
「BLDC電機」	指	直流無刷電機，一種使用電子控制取代碳刷和換向器的電機
「BLDC電機主控及驅動芯片」	指	包括BLDC電機主控芯片(如MCU及ASIC)及BLDC電機驅動芯片(如HVIC)
「BLDC電機驅動控制產品」	指	通常包括主控芯片、驅動芯片、功率器件、智能功率模塊(IPM)及傳感器等，所有功能協同運作，以確保BLDC電機的穩定運行及最佳性能
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「CRC」	指	循環冗餘校驗
「直流」	指	直流電流
「EDA」	指	電子設計自動化
「fabless」	指	實體專注於芯片的研發和設計，並將生產外包給外部廠商的業務模式

技術詞彙表

「最終規則」	指	美國財政部頒佈《關於美國在受關注國家投資有關國家安全技術和產品的規定》(Provisions Pertaining to U.S. Investments in Certain National Security Technologies and Products in Countries of Concern)，該規定實施對外投資計劃，限制美國人士及美國控制實體的投資，該計劃由第14105號行政令《關於解決美國對受關注國家的特定國家安全技術和產品投資》(Addressing United States Investments in Certain National Security Technologies and Products in Countries of Concern)(「對外命令」)所實施。最終規則於2025年1月2日生效。
「FOC」	指	磁場定向控制，也稱矢量變頻
「晶圓廠」	指	專門從事生產和製造集成電路領域芯片的製造商
「HVIC」	指	高壓芯片，一種電機驅動芯片，可提供高低壓隔離，同時提高驅動能力，讓電機主控芯片可透過HVIC芯片間接驅動MOSFET
「I2C」	指	旨在允許多個外設數字集成電路與一個或多個控制器芯片進行傳輸的協議
「芯片」或「集成電路」	指	在一小片半導體材料上的一組電子電路
「IPM」	指	智能功率模塊
「方波」	指	週期性的非正弦波形，其特徵是信號值在一個週期內於兩個固定電平之間快速切換
「LDO」	指	低壓差線性穩壓器，能於非常小輸出輸入電壓差的情況下工作的一種穩壓器
「LIN」	指	低成本串行通信接口
「MCU」	指	微控制單元，一種包含通用處理器內核、輸入／輸出接口及其他模組的芯片，用於各種應用，例如電機驅動控制
「ME內核」	指	電機引擎內核的簡稱，是我們專有的電機驅動控制處理器內核

技術詞彙表

「MOSFET」	指	金屬氧化物半導體場效應晶體管，一種用於放大或切換電子信號的晶體管
「OEM」	指	原始設備製造，製造商按照客戶設計及規格製造產品並由該客戶品牌名稱或並無特定品牌推廣及銷售
「運算放大器」	指	模擬電路模組，可接收差動電壓輸入並產生單端電壓輸出
「PCB」	指	印製電路板，連接各種元件的電路板
「預驅動」	指	一種用於驅動電機(將低功率信號轉換為高功率輸出)的部件
「PWM」	指	脈寬調製，透過改變脈寬的佔空比調整輸出及波形
「研發」	指	研究與開發
「轉子」	指	電機的移動／旋轉部件
「RPM」	指	每分鐘轉速
「傳感器」	指	量測或偵測現實世界狀況(如動作、熱力或光線)，並將狀況轉換為模擬或數位表示的裝置
「無感」	指	不使用傳感器
「單相」	指	單一電流。單相BLDC電機是一種其線圈使用單一電流運作的BLDC電機
「SPI」	指	串行外設接口
「SVPWM」	指	空間矢量脈寬調製，其通過合成空間矢量模擬圓形或橢圓形旋轉磁場
「定子」	指	電機的靜止部件
「三相」	指	三個獨立電流。三相BLDC電機是在線圈中使用三個獨立電流運作的BLDC電機

技術詞彙表

「UART」	指	通用異步收發傳輸器
「無人機」	指	無人機
「微秒」	指	微秒，等於一百萬分之一秒